

证券代码：300782

证券简称：卓胜微



关于江苏卓胜微电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 (修订稿)

保荐机构（主承销商）



（北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

二〇二〇年九月

深圳证券交易所:

根据贵所于 2020 年 8 月 3 日出具的《关于江苏卓胜微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020095 号），江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”、“公司”、“发行人”或“申请人”）与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、天元律师事务所（以下简称“律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复报告中的简称与《江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》中“释义”所定义的简称具有相同含义。

目 录

目 录	3
问题一	4
问题二	21
问题三	26
问题四	37
问题五	41

问题一

发行人 2019 年 6 月首次公开发行股票募投项目为射频滤波器芯片及模组研发及产业化等 3 个项目，项目达到预定可使用状态时间为 2021 年 11 月，截至 2020 年 3 月 31 日募集资金仅投入 26.52%。本次发行募投项目为高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目（以下简称射频滤波器项目）、5G 通信基站射频器件研发及产业化项目（以下简称基站射频器件项目）及补充流动资金。

请发行人补充说明或披露：（1）说明各募投项目（不含补充流动资金）的主要产品、产能及其与前次募投项目、现有业务之间的联系与区别，在前次募投项目均未实施完毕的情况下，短期内再次大额融资进行项目建设的必要性、合理性和谨慎性，是否存在重复建设情况，并结合客户储备、在手订单、现有产能规模及产能利用率等、技术迭代周期等情况说明新增产能规模的合理性及市场消化能力，项目实施是否存在重大不确定性；（2）说明射频滤波器项目、基站射频器件项目中“硬件设备费”的构成明细，是否全部为资本性支出；（3）披露本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排，本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金；（4）披露各募投项目的用地计划、取得土地的具体安排、进度，是否符合土地政策、城市规划，募投项目用地落实的风险；（5）说明前次募集资金投向是否发生变更、是否按计划投入，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日时间间隔是否符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的有关规定。

请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、对问题的回复

（一）说明各募投项目（不含补充流动资金）的主要产品、产能及其与前次募投项目、现有业务之间的联系与区别，在前次募投项目均未实施完毕的情况下，短期内再次大额融资进行项目建设的必要性、合理性和谨慎性，是否存在重复建设情况，并结合客户储备、在手订单、现有产能规模及产能利用率等、技术迭代周期等情况说明新增产能规模的合理性及市场消化能力，项目实施是否存

在重大不确定性

1、说明各募投项目（不含补充流动资金）的主要产品、产能及其与前次募投项目、现有业务之间的联系与区别

（1）高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目

滤波器是用于选择特定频率有用信号、移除无用频率干扰信号的一类电子元件，目前，应用于移动智能终端设备的声学滤波器主要包括 SAW（Surface Acoustic Wave，声表面波）滤波器和 BAW（Bulk Acoustic Wave，体声波）滤波器等，并可进一步分为基本 SAW、TC-SAW（Temperature Compensated –SAW，温度补偿 SAW）、IHP-SAW（Incredible High Performance-SAW，高性能 SAW）、SMR-BAW（Solidly Mounted Resonator-BAW，固体装配型 BAW）、FBAR（Film Bulk Acoustic Resonator，薄膜体声波谐振器）等。上述各类滤波器器件的特性对比情况如下：

项目	SAW			BAW	
	普通 SAW	TC-SAW	IHP-SAW	SMR-BAW	FBAR
	Surface Acoustic Wave	Temperature Compensated -SAW	Incredible High Performance-SAW	Solidly Mounted Resonator-BAW	Film Bulk Acoustic Resonator
	前次募投项目涉及的技术领域	本次募投项目可能涉及的相关技术领域			
基本原理	声波沿晶体表面横向传播			声波沿晶体内部纵向传播	
应用领域	2/3G 频段、部分 4G 频段			2/3/4/5G 频段	
适用频段	2.5GHz 以下		3.5GHz 以下	6GHz 以下	7GHz 以下
带宽水平	较低	较低	中等	中等	较高
成本及工艺难度	简易	较为简易	较为简易	较高	高
主要优势	高性价比，低频领域适用性强	性价比较高，温度稳定性强	性价比较高，性能较好，适用频段提高	整体性能较为突出	整体性能突出

本次募投项目“高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目”主要聚焦高端滤波器，其主要产品包括以 TC-SAW、IHP-SAW、SMR-BAW 和 FBAR 等为代表的高频率、高功率、高性能滤波器。

前次募投项目“射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目”的主要产品为主要应用于 2.5GHz 以下频段的 SAW 滤波器、双工器及相应的接收通路和发射通路模组，目前公司已完成了多款 SAW 滤波器产品的开发，并基于此推出了射频滤波器分集接收模组产品（DiFEM）和射频低噪声放大器/滤波器集成模组产品

(LFEM)。

公司本次募投项目所开发的产品与前次募投项目和现有产品同属于射频滤波器芯片及模组，但在具体原理、材料及工艺上存在一定差异，因而具有不同的性能表现，并在不同的应用领域中各具优势，从而形成了目标市场的互补。

公司本次募投项目所开发的产品通过采用与现有产品不同的材料、原理或工艺，一方面将全方位地实现滤波器性能的提升，另一方面进行向高频应用场景的拓展，是对公司现有产品线的完善。本次募投项目建设完成后，公司将实现向高端滤波器的延伸，从而建立覆盖高性价比 SAW 滤波器、高性能滤波器及高频滤波器的全面产品线，其中各类型产品具有不同的优势和适用领域，能够满足各细分市场的应用需求，符合当今市场的整体发展趋势。

(2) 5G 通信基站射频器件研发及产业化项目

本次募投项目“5G 通信基站射频器件研发及产业化项目”的主要产品包括：

1) 适用于 sub-6GHz 频段（**频段范围低于 6GHz**）的射频器件产品；2) 适用于毫米波频段（**频段范围在 30GHz-300GHz 之间**）的射频器件产品，上述产品将用于 5G 通信基站。

前次募投项目“射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目”及“射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目”以应用移动终端设备的射频器件开发为主。目前，公司产品线已实现对应用于移动终端的 sub-6GHz 频段射频开关、低噪声放大器及接收端射频模组的覆盖。

本次募投项目所开发的产品与前次募投项目和现有产品同属于射频器件，但主要应用于 5G 通信基站领域。与移动终端射频器件要求的低成本、小尺寸、低功耗不同，高性能、高可靠性、高稳定性是通信基站射频器件实际应用中关键考虑因素，在设计、工艺和材料选取上与移动终端射频器件存在本质差异。因此，通过本次募投项目的建设，公司将实现产品应用领域的拓展，从而开发更为广阔的市场空间。

综上所述，本次募投项目“**高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目**”和“**5G 通信基站射频器件研发及产业化项目**”的主要产品是对前次募投项目及

现有产品线的升级与拓展。通过本次募投项目的实施，公司一方面将推动其产品结构向着性能更佳、高可靠、高稳定性的方向延伸，另一方面将在移动终端的基础上扩展其产品的应用领域，从而丰富公司产品布局，实现市场地位和盈利能力的同步提升。

（3）产能情况

目前，公司主要采用 Fabless 经营模式（无芯片制造工厂的 IC 设计公司采用的经营模式），专注于集成电路的研发、设计与销售，将产品的晶圆制造及封装测试环节委托给代工厂进行，不涉及自有产能。公司与主要供应商建立了深入、稳定的合作关系，产能需求能够得到稳定保障，在历史经营过程中未出现因上游产能供给不足影响产品交付的情形。公司将通过本次募投项目的实施，进一步深化与晶圆代工厂的合作，有助于提升产能保障力度及稳定性。

公司本次募投项目拟通过与晶圆代工厂合作建立生产专线的形式进行，公司提供部分关键设备，但不拥有完整的产线，对应的产能规模主要取决于后续生产专线的规划及实际运营情况。公司此次募投项目的规划，充分考虑了新产品预计的产销量情况，产能需求预计能够得到稳定保障。

综上所述，公司本次募投项目的实施通过生产专线的合作建设，能够在现有 Fabless 经营模式的基础上加强对上游产能的掌控力度，有助于公司利用晶圆厂生产专线进行更为高效的工艺研发，同时有效保障了公司产能供给的稳定。

2、在前次募投项目均未实施完毕的情况下，短期内再次大额融资进行项目建设的必要性、合理性和谨慎性，是否存在重复建设情况

一方面，公司本次募投项目的实施有助于实现全产品线覆盖。射频前端器件主要包括射频滤波器、射频功率放大器、射频开关、射频低噪声放大器等，根据 QYR Electronics Research Center, Feb. 2019，前述射频器件 2019 年的全球市场份额分别为 59.01%、18.68%、11.23%和 8.78%。公司通过前次募投项目的实施，现有产品结构已覆盖应用于智能终端设备的射频开关、低噪声放大器、SAW 滤波器等器件，并将进一步开发射频功率放大器。本次募投项目的实施将推动公司产品向通讯基站应用领域、高端射频滤波器等方向拓展，从而实现射频器件领域更为全面的产品覆盖。在 5G 应用的带动下，终端设备中所搭载的高

端滤波器显著增多，同时 5G 通讯基站的建设高速进行，因此公司拟开发的新产品拥有广阔的市场前景，符合行业发展趋势，能够强化与现有业务的协同效应，并推动公司产品结构的完善与盈利能力的提升。

另一方面，公司本次募投项目的实施有助于提升对产业链上游的参与程度。与采用 IDM 经营模式（Integrated Device Manufacturing，垂直整合制造模式，包含了芯片设计、晶圆制造、封测等全部芯片制造环节）的国际龙头厂商相比，公司在 Fabless 经营模式下尚未拥有自主产能，需委托晶圆代工厂进行晶圆制造。基于高端滤波器的晶圆先进制程和工艺均掌握在以 IDM 为经营模式的国际头部企业手中，因而代工模式的制造工艺水平还未发展到足够成熟的地步，且出于成本效益的考虑，缺乏进行设备升级的动力。本次募投项目通过购置一定规模的晶圆制造设备，将与晶圆代工厂合作建立生产专线，有助于双方形成优势互补，保障设计成果的快速、稳定实现。

对本次募投项目的必要性、合理性和谨慎性具体分析如下：

（1）公司本次募投项目将有助于加速射频器件的国产化替代

近年来，5G 技术应用的加速落地带动了上游相关器件需求的快速增长，公司通过前次募投项目的建设，已在 SAW 滤波器及其他射频器件上实现了技术突破，推动了相关产品的国产化替代。然而，国内厂商在高端射频滤波器及通信基站射频器件领域较之国际厂商仍然有着较大的差距，在中美贸易摩擦的市场环境下，相关产品的国产化替代迫在眉睫。

公司本次募投项目拟在前次募投项目及现有产品的基础上，布局高端滤波器及 5G 通信基站射频器件，是当前通信技术迭代下打破国外厂商垄断的必然选择。

（2）公司需通过持续的新产品开发紧跟行业发展趋势，强化与现有业务的协同效应，形成更为全面的产品结构

随着 5G 商业化的建设迎来增速高峰，一方面，市场应用在 sub-6GHz 和毫米波等高频领域不断拓展，对以 TC-SAW、IHP-SAW、BAW 等工艺为代表的高性能、高频滤波器需求大幅增加，并要求通过高集成度的射频前端模组实现产品的复杂化、高端化、小型化发展；另一方面，高频通信基站的覆盖范围较低，需

针对 5G 需求进行大规模网络基础设施扩容和新建，配套射频前端器件的市场空间广阔。

面对快速更迭的市场需求及技术趋势，公司需保持较高的行业敏感度，顺应市场发展动态，不拘泥于现有产品布局，通过新产品的持续开发拓展新的利润增长点。本次募投项目所研发的高端射频滤波器芯片及模组、5G 通信基站射频器件与市场未来发展的必然趋势高度契合，有助于公司发挥新产品与现有产品的协同与互补效应，**形成更为全面的产品结构**，向行业前沿不断靠拢。

（3）公司拟开发的新产品市场前景广阔

一方面，全球滤波器市场规模在通信技术的更迭下持续扩张；另一方面，5G 基站所需的大规模天线阵列、MIMO 将给射频市场带来巨大的成长机遇，室内小基站作为提升 5G 网络覆盖深度和容量的必要手段也将推动射频市场的增长。本次募投项目拟开发的新产品具有广阔的市场前景，公司凭借现有的技术和客户基础，能够实现良好的市场导入。

（4）通过合作生产专线的建立，公司将提升对供应链的参与程度

目前，全球范围内主要射频前端供应商大多采用 IDM 经营模式，拥有设计、制造和封测的全产业链能力，在新产品、新材料的开发过程中对于制造工艺具备更为深入的理解，并能够根据市场最新需求及时进行设备和工艺的迭代。

为了达到兼具设计研究、晶圆制造、封装测试的全产业链参与，实现对关键制造环节的控制和自主供给，公司本次募投项目拟与 Foundry 代工厂（**晶圆代工厂，指专门负责生产、制造芯片的厂家**）合作建立生产专线，由双方充分发挥各自优势，合作完成产品工艺的调整与工艺能力的提升。公司拟在充分利用晶圆代工厂现有资源的前提下，购置部分具备较高技术难度和定制化水平的设备，因此需利用本次募集资金在硬件设备上进行一定规模的投入。

（5）本次募投项目是对前次募投项目所开发的产品的拓展与升级，二者可同步进行

公司本次募投项目所开发的产品包括高端射频滤波器芯片及模组、5G 通信基站射频前端器件，前者是在公司现有 SAW 滤波器的基础上对产品线的丰富，

后者是对公司现有射频前端器件产品应用领域上的拓展，具体情况参见本问题回复之“1、各募投项目的主要产品、产能及其与前次募投项目、现有业务之间的联系与区别”。

本次募投项目的拟开发产品在性能表现、复杂度、应用场景方面与前次募投项目存在显著差异，因此二者相对独立。前次募投项目的完结与本次募投项目的启动不存在必然关联，公司可同步进行相关项目的研发，从而确保新产品及时投入市场。

（6）前次募投项目的建设已初具成果，为本次募投项目打下了坚实的基础

截至本回复报告出具日，公司通过前次募投项目的开发，已推出了 SAW 滤波器芯片、射频滤波器分集接收模组（DiFEM）、射频低噪声放大器/SAW 滤波器集成模组产品（LFEM）以及支持 sub-6GHz 的射频开关、射频低噪声放大器等芯片和其他模组产品，形成了覆盖 RF CMOS、SOI、SiGe、GaAs、压电晶体等各种材料及相关工艺的技术平台，并在前道设计流程和后道生产流程的验证上积累了丰富的经验。同时，公司现有产品已实现向绝大部分安卓系统知名手机终端厂商的渗透，此类知名手机终端厂商客户将仍是公司未来新产品推广的主要目标群体。

凭借现有的产品及技术储备，公司已经具备了向高频化、多元化、高端化演进和向新市场、新领域拓展的能力，并能够实现向既有客户的快速导入。因此，本次募投项目的建设已经具备了良好的技术与客户基础，在现阶段启动相关产品的研发具有合理性。

（7）公司对本次募投项目开支进行了谨慎、合理规划

本次募集资金的投入将主要用于硬件设备等的购置，公司充分考虑了晶圆制造厂商已经普遍具备的生产资源，对于关键生产环节的必要新增设备进行了明确、合理的计划，所需投入的募集资金规模估计较为谨慎。相关设备购置的规划情况详见本回复报告“问题一”之“（二）说明射频滤波器项目、基站射频器件项目中‘硬件设备费’的构成明细，是否全部为资本性支出”。

综上所述，本次融资的投资项目符合公司发展的必要需求，是基于现有业务

基础的合理规划。本次募投项目所开发的产品在技术性能、工艺选择及应用领域上有别于前次募投项目，不存在重复建设的情形。

3、结合客户储备、在手订单、现有产能规模及产能利用率等、技术迭代周期等情况说明新增产能规模的合理性及市场消化能力，项目实施是否存在重大不确定性

(1) 公司的客户储备情况

目前，公司的射频低噪声放大器、射频开关、射频天线调谐开关等产品均已实现 sub-6GHz 频段的覆盖，获得了知名手机品牌客户的认可并搭载于其移动终端设备中。

未来，公司新产品的推广仍将以手机品牌客户为主要目标群体，借助现有客户储备实现市场导入。一方面，作为此类品牌客户的合格供应商，发行人与客户保持长期合作及交流，对客户的需求及其产品的性能与品质具有充分理解，有助于推动高端射频滤波器等新产品的导入；另一方面，公司现有移动终端客户群体与通信基站射频器件的潜在客户群体存在一定重叠，为公司后续的基站射频器件的推广奠定了基础。

(2) 公司的在手订单、现有产能规模及产能利用率等情况

公司本次募投项目主要进行新产品的研发及产业化，市场对相关产品已具备较为广阔的需求空间，**公司将根据客户实际产品需求及预测销量情况，设计规划项目产线产能情况。**待项目建设完成后，公司将积极向客户送样并进行产品验证。新产品验证通过后，公司将推动客户导入，届时将正式获取订单，从而实现新产品的量产与交付。**后续实际运营阶段，公司将根据客户需求及在手订单情况，对产线所投入的产能进行动态调整，保证较高的产能利用率。**对于现有产品，公司客户群体均为国内外知名手机厂商，公司产品在性能、价格、质量、交付、技术等各方面获得客户的广泛认可并逐步实现深入渗透。因此，基于良好的客户基础，公司现有产品能够持续获得下游订单，具备良好的在手订单储备，能够实现产品的稳定量产与交付，并为公司的持续盈利提供稳定保障。

公司目前主要采用 Fabless 经营模式，将产品的晶圆制造及封装测试环节委

托给代工厂进行，不涉及自有产能及产能利用率。在实际经营过程中，公司根据产品的市场推广及所获取的订单情况，动态灵活地对委外产能进行调整。2019年度及2020年1-6月，针对现有的用于移动智能终端的射频开关、低噪声放大器、SAW滤波器等射频前端分立器件及各类模组等产品，公司通过委外加工方式分别达到455,048.53万颗和303,082.86万颗的产量，为产品销售提供了有效的支撑，分别实现440,601.66万颗和246,041.22万颗的销量。

未来，通过与晶圆代工厂合作建立生产专线及其他形式，公司将深化与供应商的合作，有效保障现有产品及新产品的产能供给。具体而言，在专线设计规划阶段，公司主要考虑对未来销量的合理预期、产线运转的成本效益等因素，对生产专线的产能建设进行规划；在生产专线建设运作阶段，公司将根据客户需求及在手订单情况，对产线所投入的产能进行动态调整，从而最大限度地保障新产品的产能供给，确保前期成本投入的合理性及后续效益实现的可靠性。

根据历史产品开发经验、目标市场空间、现有客户及订单基础等因素，公司预计本次募投项目所开发的应用于基站的射频器件、高端滤波器器件及模组产品将带来较高的销售增量。

(3) 公司所处行业的技术迭代情况

整体上，公司所处行业的技术发展主要受到下游市场应用需求的驱动，迭代周期相对较快。在射频滤波器领域，从4G到5G通信频段的提升推动了产品工艺的持续升级；在基站射频器件领域，5G通信基站的商业化建设推动了高频射频前端器件的普及。因此，公司需紧跟行业技术发展，持续进行新产品的拓展。具体情况如下：

在射频滤波器领域，SAW滤波器性价比优势显著，在2.5GHz以下频段具有广泛应用，市场主要参与者在普通SAW滤波器的基础上不断推出具有更优性能的TC-SAW、IHP-SAW等多种新产品。同时，随着5G应用的普及，传统SAW滤波器已无法满足高频段需求，BAW滤波器的市场需求快速增加，并推出了FBAR等具备更佳性能的新产品。公司目前已实现普通SAW滤波器的稳定出货，本次募投项目的实施将主要专注于TC-SAW、IHP-SAW、BAW和FBAR等为代表的高频率、高功率、高性能滤波器，实现向行业前沿技术及产品的拓展。

在 5G 应用射频器件领域，移动终端射频器件主要关注低成本、小尺寸、低功耗等因素，而通信基站射频器件则要求高性能、高可靠性、高稳定性等特点，导致二者在设计、工艺和材料上存在一定差异。5G 应用的推广一方面将推动通信基站射频器件向着更高频的方向发展，另一方面也带动了工艺和材料的不断升级。公司本次募投项目的实施将实现产品应用领域向通信基站端的拓展，并在此技术上不断研发行业领先技术与产品。

（4）新产品的市场消化能力，项目实施是否存在重大不确定性

公司本次募投项目所开发的新产品具备良好的市场前景，能够有效实现市场消化，具体原因如下：

第一，本次募投项目主要面向 5G 应用这一增长潜力巨大的细分市场，根据 QYR Electronics Research Center 统计，在 5G 应用的推动下，预计 2023 年全球射频滤波器市场规模将从 2018 年的 83.6 亿美元增长至 219.1 亿美元，年复合增速高达 21.2%；同时，2020 年至 2021 年也将迎来 5G 基站建设的高峰期。高端射频滤波器及 5G 通信基站射频器件的市场空间广阔，国内供应商与 Broadcom、Skyworks、Qorvo、Murata 等国际龙头厂商相比市场份额普遍较低，公司根据现有产品的出货情况及客户储备情况，保守预计了新产品的销售情况。基于广阔的下游市场空间，公司在前期市场占有率较低时，对应的产品销量已然具备一定规模。

第二，通过分阶段产品研发的形式，公司将适时推出满足市场主流需求的新产品，以精准把握广阔的市场增量空间，能够有效避免在新产品开发与推广过程中错失市场机遇、产品定位不契合市场需求等情况的发生。目前，公司具有稳固的客户资源储备，有助于快速导入以现有产品为基础而开发的新产品，在分阶段产品研发的策略下，能够充分利用产能并占据市场份额。

第三，公司在射频领域深耕多年，具有良好的技术积累和客户合作基础，且本次募投项目的客户群体与现有产品重合度较高，有利于本次募投项目产品的推广并实现最终销售；在此基础上，公司生产专线的产能规划将以合理销售预期等因素为前提，实现建设产能与实际销售规模的匹配，确保所建设的专线产能得到市场订单保障，所开发的新产品能够稳定出货并得到市场认可。

综上所述，（1）公司目前已具备了较为丰富的客户资源储备，现有产品的在手订单规模稳定，能够在新产品开发完成后实现良好的订单转化，并确保良好的销售业绩；（2）公司新产品的产能规模设计将以销售预期为基础，并在实际运作过程中进行动态调整，以保障较高的产能利用率；（3）公司本次募投项目的建设将紧跟行业技术发展趋势，推出满足市场最新需求的产品，从而获得良好的市场认可；（4）公司所开发的新产品市场空间广阔，在分阶段产品研发、产能规划动态调整等策略下，结合现有客户资源，能有效实现市场消化。因此，发行人本次募投项目的实施不存在重大不确定性。

（二）说明射频滤波器项目、基站射频器件项目中“硬件设备费”的构成明细，是否全部为资本性支出

射频滤波器项目的硬件设备费构成如下：

序号	设备分类	设备名称	金额（万元）
1	清洗设备	湿法清洗机	14,140.00
		甩干机	
		等离子处理/打胶	
		擦片机	
2	涂显设备	增粘	17,640.00
		涂胶台	
		显影	
3	光刻设备	光刻机 1	29,400.00
		光刻机 2	
4	薄膜制备	镀膜机 1	38,080.00
		镀膜机 2	
		磁控溅射台(PVD)	
		PECVD 等离子增强化学气相沉积	
		集群式高精度溅射台	
5	蚀刻设备	ETCH 干法刻蚀机台	3,780.00
		干法释放设备	
6	检测设备	全半自动探针台卡	18,980.77
		AOI 光学晶圆外观检查	
		SEM 扫描电子显微镜	

序号	设备分类	设备名称	金额（万元）
		FIB 聚焦离子束	
		自动批产台阶仪（薄膜轮廓仪）	
		手动台阶仪（薄膜轮廓仪）	
		CD-SEM 关键尺寸测量	
7	其他	矢量网络分析仪	19,740.00
		CMP 化学物理研磨设备	
		剥离机	
		晶圆级氮气柜	
		晶圆老化退火炉	
合计			141,760.77

基站射频器件项目的硬件设备费构成如下：

序号	设备分类	设备清单	金额（万元）
1	光刻设备	光刻机 1	21,000.00
		光刻机 2	
2	薄膜制备	等离子 CVD（电浆）	25,298.00
		金属溅射	
		PECVD	
		磁控溅射镀膜机	
3	蚀刻设备	氧化膜干蚀刻	8,193.00
		背面晶圆干蚀刻	
		金蚀刻	
4	晶圆检测	自动外观检查仪	7,735.00
		套刻图案尺寸测量机	
5	氧化扩散退火	RTA	3,198.00
		氧化/扩散	
6	其他	薄膜厚度及声速测量	18,369.00
		自动剥离装置	
合计			83,793.00

上述硬件设备费均为资本性支出。

（三）披露本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排，本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金

射频滤波器项目的募集资金预计使用进度如下：

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
募集资金投入金额（万元）	58,212.31	28,431.15	7,354.77	29,022.15	18,740.38

射频滤波器项目的项目预计建设进度如下：

本项目建设工期为 5 年，共分两期进行，具体情况如下：

建设期	时间	具体内容
一期	T+1-T+3	研发方案制定
		硬件设备购置安装调试
		研发人员引进与培训
		项目设计开发
		测试及产品化
二期	T+4-T+5	研发方案制定
		硬件设备购置安装调试
		研发人员引进与培训
		项目设计开发
		测试及产品化

发行人未在本次发行相关董事会决议日前投入与本次募投项目相关资金。

基站射频器件项目的募集资金预计使用进度如下：

项目	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
募集资金投入金额(万元)	32,873.00	15,355.00	17,181.00	9,817.00	8,567.00

基站射频器件项目的项目预计建设进度如下：

本项目建设工期为 5 年，共分两期进行，具体情况如下：

建设期	时间	具体内容
一期	T+1-T+3	研发方案制定
		硬件设备购置安装调试
		研发人员引进与培训
		项目设计开发
		测试及产品化
二期	T+4-T+5	研发方案制定
		硬件设备购置安装调试

建设期	时间	具体内容
		研发人员引进与培训
		项目设计开发
		测试及产品化

发行人未在本次发行相关董事会决议日前投入与本次募投项目相关资金。

（四）披露各募投项目的用地计划、取得土地的具体安排、进度，是否符合土地政策、城市规划，募投项目用地落实的风险

公司本次募投项目通过与晶圆厂商共同投入资源合作建立前道晶圆生产专线进行实施，其中硬件设备未来会放置在晶圆厂商自有或自用的厂房中，本次募投项目不涉及发行人需要取得用地的情况，不存在用地落实的风险。晶圆厂商自有或自用的土地，需符合土地政策、城市规划等相关法律法规的规定。

（五）说明前次募集资金投向是否发生变更、是否按计划投入，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日时间间隔符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的有关规定

1、本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日时间间隔超过 6 个月

公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]939 号），首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，募集资金总额 88,225.00 万元。扣除发行费用人民币 5,339.26 万元，募集资金净额为人民币 82,885.74 万元。前次募集资金已于 2019 年 6 月 11 日到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字[2019]第 ZA14999 号《验资报告》确认，距本次发行董事会决议日（2020 年 5 月 29 日）时间间隔超过 6 个月。

2、投向未发生变更且按计划投入

（1）前次募集资金使用情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司前次募集资金使用情况如下：

单位：万元				
承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	投入比例	项目达到预定可使用状态日期

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	投入比例	项目达到预定可使用状态日期
射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目	40,521.69	5,763.88	14.22%	2021 年 11 月 16 日
射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目	25,499.18	2,434.45	9.55%	2021 年 11 月 16 日
射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目	16,864.87	13,784.84	81.74%	2021 年 11 月 16 日
合计	82,885.74	21,983.17	26.52%	

随着 4G 网络的扩张和 5G 应用下高频段网络的发展,智能终端对射频开关、高性能射频 LNA、射频滤波器、射频功率放大器等产品的需求快速增加,并显现出了模组化、小型化、集成化的发展趋势,天线调谐开关等产品的市场空间也愈发广阔。公司经过审慎评估,优化了建设节奏并明确了前期重点研发方向,将射频开关、射频 LNA 及射频滤波器模块作为项目建设初期的战略重心,从而更好地顺应市场需求并满足公司现有的业务需要。

截至本回复报告出具日,公司的前次各募投项目的具体进展如下:1) 射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目作为现阶段战略重心之一,实现了顺利推进,适用于 5G 通信制式的 sub-6GHz 频段射频开关、天线调谐开关及 SiGe 工艺 LNA 等新产品完成了向品牌客户的量产导入,销量快速增长;2) 射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目将原计划于后期实施的滤波器模块研发作为现阶段战略重心之一,并相应予以前置,实现了射频前端模组从无到有的突破;3) 射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目是公司中长期发展战略之一,其研发团队已完成部署,项目有序推进并有数款 WiFi 射频功率放大器芯片和高度集成的 WiFi 前端模组产品进入正式量产阶段。

综上所述,公司上述三个募投项目的实施情况及进展有助于公司把握市场机遇、响应客户需求,充分考虑了通信技术市场的发展趋势,为公司带来了新的爆发增长点,同时加速了公司技术升级与创新成果的实现,提升了公司在射频前端市场的竞争力,为后续项目的顺利实施奠定了基础。

(2) 前次募集资金的后续投入计划

为了确保前次募投项目顺利推进并如期完成,公司出具了如下承诺:“本公司承诺,上述募集资金投资项目均处于正常进行中,后续能够按照既定计划完成建设,不会出现项目建设延缓的情形。”

公司前次各募投项目均处于有序推进中，后续预计仍能按计划投入并如期完成建设，前次募集资金投向未发生变更且按计划投入。

综上所述，公司本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日时间间隔超过6个月，前次募集资金投向未发生变更且按计划投入，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的有关规定。

二、募集说明书补充披露

发行人已在募集说明书“三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“（一）本次募集资金投资项目的的基本情况”补充披露本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排、本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金以及各募投项目用地情况。

三、中介机构核查意见

保荐机构、发行人律师执行了如下的核查程序：

1、获取并查阅了公司前次及本次募集资金投资项目的可行性研究报告，对各募投项目的主要产品、现有业务之间的联系与区别进行分析；获取本次募投项目中硬件设备费的构成明细；向公司了解本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排、用地计划、本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金；

2、核查了公司现有客户储备；

3、查阅相关行业研究报告，分析公司及其募投项目所处的行业及技术发展情况；

4、取得并查阅了申报会计师出具的《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，了解并核实了发行人前次募集资金的使用状况；

5、对公司高级管理人员就各募投项目的投资进展及未来投资规划进行了解，对公司财务人员就前次募集资金的具体投入内容进行了解；

6、获取了公司关于前次募集资金出具的说明及承诺；

7、获取并查阅了前次募集资金专户的银行对账单，并针对大额开支进行了

抽样核查。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：

1、发行人本次募投项目的主要产品是对前次募投项目及现有产品的拓展与升级，本次募投项目的规划具有必要性、合理性和谨慎性，不存在重复建设的情形；

2、发行人具有丰富的客户资源储备，本次募投项目相关产品符合市场主流需求，具有良好的盈利前景，项目实施不存在重大不确定性；

3、射频滤波器项目、基站射频器件项目中硬件设备费均为资本性支出，本次募集资金不包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金；

4、本次募投项目不涉及发行人需要取得用地的情况，不存在用地落实的风险；

5、公司本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日时间间隔超过 6 个月，前次募集资金投向未发生变更且按计划投入，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的有关规定。

问题二

本次 2 个募投项目均与晶圆制造商合作建立前道晶圆生产专线。

请发行人披露与晶圆制造商合作的具体方式，包括但不限于合作协议主要内容及签署情况、生产专线等设施设备使用、维护的具体安排，产线及产能的最终所有权归属、发行人与晶圆制造商具体投入的人力、技术和设备等资源的相关情况、项目利润分配计划等事项，生产专线产能及良品率能否有效满足发行人需求，发行人能否对募投项目实施有效控制，并充分披露相应风险。

请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

一、对问题的回复

（一）披露与晶圆制造商合作的具体方式，包括但不限于合作协议主要内容及签署情况、生产专线等设施设备使用、维护的具体安排，产线及产能的最终所有权归属、发行人与晶圆制造商具体投入的人力、技术和设备等资源的相关情况、项目利润分配计划等事项，生产专线产能及良品率能否有效满足发行人需求，发行人能否对募投项目实施有效控制

随着通信技术的快速发展，产品趋向复杂化、高端化，射频前端器件生产过程中的定制化需求逐步提高，设计企业将标准化程度较高的生产环节通过委外方式进行，而对于部分产品独有的特殊工艺则由企业自主完成，从而实现了研发、生产效率的提升与成本的压缩。

公司本次募投项目与晶圆代工厂合作建立生产专线的形式进行，公司提供部分关键设备，同时将约定全部或部分公司所投入设备所在专线用于公司产品的生产，形成的新工艺和技术由公司所有。

1、合作协议主要内容及签署情况

截至目前，公司尚未与晶圆制造商签署关于本次募投项目的合作协议，相关合作方尚处于前期尽调研究阶段，合作方式、合作条款等具体内容尚在谈判过程中。后续如有进展，公司将根据相关规定的要求，及时履行信息披露义务。

公司子公司参股投资了常州承芯半导体有限公司，该公司计划投资建设化合物半导体及微机电系统生产线，用于高端射频前端应用及光电子应用的半导体制造。该项目目前处于前期建设过程中，后续公司存在与其合作建设专线的潜在可能。另外，公司与现有供应商均存在合作的空间或可能性。

2、生产专线等设施的具体合作情况

根据行业惯例及历史经验，公司会与供应商签署商业合同，对专线的使用权进行明确约定，视实际产能的需求，通常会约定全部或者部分产线（通常为公司购买设备）的产能用于公司产品的生产需求，即只能专门用于公司订单的生产。专线由供应商生产人员管理，公司也会派出相应的驻场工程师对专线进行日常监控，公司所购置的设备清楚标识为公司财产，供应商也会定期发送设备使用报告给公司。生产专线等设施设备的管理、维护、保养的义务由供应商承担，公司享有其出资购买设备的最终所有权。同时，公司也会派出相应的工艺研发工程师，参与新工艺与新技术的研究开发，专线形成的新工艺和技术通常归公司所有。

为确保供应商的利益，合同中通常会视情况约定最低产能使用效率，若公司未达到相应的采购数量，则需给供应商一定的利益补偿。同时，针对公司前期投入的设备成本，供应商通过生产专线的成本清算，以适当降低公司采购价格等方式进行补偿，专线不涉及项目的直接利润分配。生产专线的产能及良品率预计能有效满足发行人需求，发行人对募投项目的实施可以有效控制。

3、公司具备与供应商进行类似合作的经验

（1）与苏州日月新半导体有限公司（以下简称“日月新”）的专线合作

公司与日月新签署《封装及测试服务合约》以及《合作备忘录》，双方合作建设专线，截至目前合作情况良好。部分条款如下：

1）试运行期间，日月新承诺按照每月特定产能配置专线用于生产公司委托产品，公司承诺提供充足的订单以支持专线生产。

2）日月新购买或租赁为实施本合约规定封装服务的相关设备，公司购买或租赁为实施本合约规定测试服务的相关设备（以下简称“受托加工设备”）。于合约的整个有效期限，受托加工设备的权力、所有权及货损风险属于公司所有，日

月新不得将受托加工设备的所有权、保管权或控制权转移予任何第三方，除非依据公司的书面指示进行。受托加工设备仅可以为本合约目的之使用，维护、保养费用由日月新承担。由公司支付款项的设备或工具应清楚标识为公司之财产，且于未使用时独立存放。

3) 公司每月向日月新提供滚动式预测，并约定一定时间的冻结期，若实际数量比冻结期间的预测数量减少，公司应将相应零件与材料购买成本补偿给日月新。

同时，合约中也相应约定了违约责任条款，如日月新未能履行合约规定义务，将承担其责任，并赔偿公司损失。

在与日月新的合作中，双方合作开发封测工艺，发行人投入的人员主要为驻场工程师，同时发行人共计投入数十台设备，产线生产的产品中涉及发行人的产品包括射频开关、射频低噪声放大器、射频模组等，涵盖了发行人的主要产品。通过与日月新合作设立专线，发行人确保了产品的封测产能，良率能有效满足公司要求，同时生产效率也得到进一步提升，建立了与日月新的良好战略合作关系。

(2) 与其他供应商的类似合作

公司与部分晶圆供应商、封测供应商也存在使用公司购买的设备，放置于供应商处进行生产合作的方式，合作情况良好，可以及时响应公司需求，**产能及良率均能有效满足公司要求**，为后续本项目的专线合作积累了较为丰富的管理及运营经验。

4、发行人能否对募投项目实施有效控制

基于历史上与供应商的良好合作模式，借鉴其成功的合作经验，发行人可以对本次募投项目的实施进行有效控制，具体手段包括：(1) 约定受托加工设备的权力、所有权及货损风险属于公司所有，将相关设备清楚标识为公司财产，获取供应商定期发送的设备使用报告；(2) 派出隶属于公司的长期驻场工程师对专线进行日常监控，并派出隶属于公司的工艺研发工程师，参与新工艺与新技术的研究开发，专线形成的新工艺和技术通常归公司所有；(3) 通过协议签

署确保相关产线专门用于公司订单的生产，通过向供应商提供滚动预测的形式确保产能稳定性；（4）通过违约责任的约定，确保合作方履行协议义务，如违约将赔偿公司损失。

综上所述，发行人可以对本次募投项目的实施进行有效的控制。

（二）充分披露相应风险

发行人已在募集说明书中“五、与本次发行相关的风险因素”之“（三）对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素”披露如下：

1、募投项目实施风险

虽然公司对本次募集资金投资项目进行了慎重的可行性研究论证，但多个项目的同时实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求，且与Foundry共同投入建立前道晶圆生产专线对公司的内外部资源整合能力要求较高。若公司与晶圆代工厂合作建设产线的进展有所放缓，将对募投项目后续的实施效果带来一定影响。此外，随着新产品的持续开发与晶圆生产专线的陆续搭建，公司的资产规模及业务复杂度将进一步提升，研发、运营和管理人员将相应增加，如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力，可能会影响项目研发及建设进程，导致项目未能按期投入运营的风险。

本次募投项目的实施将以与晶圆代工厂合作建立生产专线的形式进行，公司的经营模式将在原Fabless模式的基础上加强对上游供应环节的参与程度，并通过生产专线在一定程度上实现对产能的深入绑定。在与晶圆代工厂合作的过程中，若因双方商务条款难以达成一致、设备所有权及维护责任归属不明晰、公司驻场人员工作开展遇到障碍、合作方违约等情形，生产专线的建设及运作未能按计划进行，将对本次募投项目的实施造成不利影响。

本次募投的合作专线产能规划将以预期销售情况为参考依据，在项目的实施过程中，若出现下游订单不及预期、产能爬坡较慢或工艺开发不及预期等情形，将对公司生产专线的运作及产能消化带来一定不利影响，从而降低募投项目的实施效果。此外，若市场对公司新产品的认可程度较低，本次募投项目可能存在收益不及预期的风险。

二、募集说明书补充披露

发行人已在募集说明书“三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“(一)本次募集资金投资项目的的基本情况”补充披露与晶圆制造商合作的具体方式及相应的募投项目实施风险。

三、中介机构核查意见

保荐机构、发行人律师执行了如下的核查程序：

- 1、向发行人了解与晶圆制造商合作的具体方式，获取发行人历史上与供应商的合作协议；
- 2、向发行人了解其相关技术储备以及其对募投项目实施控制的具体措施以及可能产生的风险。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：

基于发行人的技术储备及过往项目经验、发行人拟对募投项目采取的控制措施，发行人预计可以对募投项目实施有效控制，发行人已在募集说明书中披露相应风险。

问题三

2020 年一季度末，发行人货币资金余额 45,906.46 万元，交易性金融资产余额 50,901.21 万元，主要为银行结构性存款。

请发行人补充说明或披露：（1）披露本次发行相关董事会决议日前六个月至今实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况，说明最近一期末是否持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形；（2）结合公司业务规模、业务增长情况、现金流状况、资产构成及资金占用情况，论证说明本次募集资金拟用于补充流动资金的原因及规模合理性。

请保荐人和会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、对问题的回复

（一）披露本次发行相关董事会决议日前六个月至今实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况，说明最近一期末是否持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形

1、披露本次发行相关董事会决议日前六个月至今实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况

（1）财务性投资和类金融业务的认定标准

1) 财务性投资

根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》问题 10：（1）财务性投资包括但不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。（3）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的 30%（不包含对类金融业务的投资金额）。（4）

本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。

2) 类金融业务

根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》问题 20，除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。

(2) 本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投资情况

2020 年 5 月 29 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。2020 年 7 月 1 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。自本次发行相关董事会决议日前六个月至今（即 2019 年 11 月 29 日至今），公司未实施或拟实施财务性投资及类金融业务。具体情况如下：

1) 设立或投资产业基金、并购基金

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在新设立或投资产业基金、并购基金的情形。

2) 拆借资金

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施借予他人款项、拆借资金的情形，不存在拆借资金余额。

3) 委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在委托贷款情形。

4) 以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不涉及集团财务公司情形。

5) 购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司存在使用闲置资金购买结构性存款、大额存单、七天通知存款的情形，主要为在满足公司各项资金使用需求的基础上，使用暂时闲置的资金购买了一年期以内的“风险较低、流动性好、安全性高”的结构性存款、大额存单、七天通知存款。公司购买上述产品旨在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

公司使用暂时闲置资金购买的结构性存款、大额存单、七天通知存款均属于“风险较低、流动性好、安全性高”的产品，且投资期限均在一年以内。因此，上述结构性存款、大额存单、七天通知存款不属于期限较长、收益波动大且风险较高的金融产品，不属于《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》规定的财务性投资或类金融业务。

自本次发行相关董事会决议日前六个月至本回复报告出具日，公司使用闲置资金购买的结构性存款、大额存单、七天通知存款明细如下：

单位：万元

机构名称	购买产品名称	产品类型	金额	参考年化收益率	起始日期	终止日期
江苏银行 无锡科技支行	7天通知存款	7天通知存款	1,000.00	1.16%	2020年2月11日	2020年4月14日
江苏银行 无锡科技支行	7天通知存款	7天通知存款	2,000.00	1.16%	2020年2月11日	2020年6月30日
江苏银行 无锡科技支行	7天通知存款	7天通知存款	2,000.00	1.16%	2020年2月11日	随时可支取
江苏银行 无锡科技支行	7天通知存款	7天通知存款	10,000.00	1.16%	2020年9月3日	随时可支取
南京银行 滨湖支行	大额存单	大额存单	1,000.00	1.60%	2020年3月23日	2020年4月23日
南京银行 滨湖支行	大额存单	大额存单	1,000.00	1.60%	2020年4月24日	2020年5月24日
南京银行 滨湖支行	大额存单	大额存单	1,000.00	1.60%	2020年5月26日	2020年6月26日

机构名称	购买产品名称	产品类型	金额	参考年化收益率	起始日期	终止日期
交通银行股份有限公司无锡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）	结构性存款	5,000.00	3.81%-3.91%	2019年9月23日	2020年6月22日
交通银行股份有限公司无锡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）	结构性存款	5,000.00	3.80%-3.90%	2019年9月23日	2020年3月23日
交通银行股份有限公司无锡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）	结构性存款	10,000.00	3.81%-3.91%	2019年9月23日	2020年9月18日
交通银行股份有限公司无锡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）	结构性存款	5,000.00	1.55%-3.75%	2020年3月25日	2020年9月15日
交通银行股份有限公司无锡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）	结构性存款	5,000.00	1.35%-3.02%	2020年6月23日	2020年12月29日
江苏银行股份有限公司无锡分行	江苏银行对公人民币结构性存款	结构性存款	25,000.00	2%-3.85%	2019年9月26日	2020年6月26日
江苏银行股份有限公司无锡分行	江苏银行对公人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	2%-3.85%	2019年10月10日	2020年7月10日
江苏银行股份有限公司无锡分行	江苏银行对公人民币结构性存款	结构性存款	20,000.00	1.5%-3.05%	2020年6月28日	2020年12月28日
江苏银行股份有限公司无锡分行	江苏银行对公人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	1.5%-3.05%	2020年6月29日	2020年12月29日
江苏银行股份有限公司无锡分行	江苏银行对公人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	1.5%-2.95%	2020年7月13日	2020年10月13日

6) 金融或类金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在经营金融业务情形，亦不存在经营融资租赁、商业保理、小贷业务等类金融业务情形。

7) 拟实施的财务性投资的具体情况

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在拟实施财务性投资的相关安排。

综上，自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的情形。

2、说明最近一期末是否持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形

截至 2020 年 6 月 30 日，公司相关资产情况具体如下：

单位：万元

序号	科目	期末余额	期末财务性投资余额
1	交易性金融资产	50,486.99	-
2	其他应收款	231.30	-
3	可供出售金融资产	-	-
4	其他流动资产	1,912.65	-
5	其他权益工具投资	6,700.00	-
6	长期股权投资	2,495.44	-
7	其他非流动资产	-	-
合计		61,826.38	-

注：以上数据未经审计。

(1) 交易性金融资产

截至 2020 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产余额为 50,486.99 万元，全部为为实现资金使用效率最大化而购买的银行结构性存款，不属于财务性投资。

(2) 其他应收款

截至 2020 年 6 月 30 日，公司其他应收款情况余额为 231.30 万元，主要为备用金、预付房租费用、押金、保证金和其他往来款等经营性往来款，不属于财务性投资。

（3）其他流动资产

截至 2020 年 6 月 30 日，公司其他流动资产余额为 1,912.65 万元，主要为待抵扣进项税、预付税金等，不属于财务性投资。

（4）其他权益工具投资

截至 2020 年 6 月 30 日，公司其他权益工具投资余额为 6,700.00 万元，分别为对南通至晟微电子有限公司和常州承芯半导体有限公司的投资。其中，南通至晟微电子有限公司的主营业务为集成电路设计与电子技术研究等，常州承芯半导体有限公司的主营业务为光电子器件、集成电路、半导体分立器件、LED 芯片、LED 外延片的研究、开发、生产制造、封装、销售及技术咨询等。

（5）长期股权投资

截至 2020 年 6 月 30 日，公司长期股权投资余额为 2,495.44 万元，全部为对上海山景集成电路股份有限公司的投资，其主营业务为集成电路及相关产品的研发、设计及销售等。

上述（4）和（5）所述投资均为公司围绕现有主业进行的产业投资，符合公司主业及战略发展方向，符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》中“不界定为财务性投资”的情形。

综上，发行人最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形。

（二）结合公司业务规模、业务增长情况、现金流状况、资产构成及资金占用情况，论证说明本次募集资金拟用于补充流动资金的原因及规模合理性

1、公司本次募投项目对非资本性资金要求较高

（1）本次募投项目产品较为复杂，研发难度较大

公司本次募投项目产品相对高端，涉及工艺较为复杂、研发人员投入相对较多、研发工作量较大。其中，高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目将针对高性能、复杂应用的高端滤波器开展设计研发，形成工艺技术能力和量产能力。通过与Foundry共同投入资源合作建立前道晶圆生产专线，深入拓展高端滤波器

产品，满足客户对定制化、高性能、高复杂度射频滤波器的需求。由于本项目产品对标国外高端产品，研发难度较大、所需投入资源较多，故所需研发费用较高。

5G通信基站射频器件研发及产业化项目将针对高频、高性能、高功率、复杂应用，适用于5G通信基站的射频器件开展设计研发，形成工艺技术能力和量产能力。通过与Foundry共同投入资源合作建立前道晶圆生产专线，对5G基站领域的射频新技术、新材料、新工艺持续创新研究。本项目的产出产品所用技术先进，可打破国外厂商在基站通信应用领域的垄断地位，故研发难度较大、所需投入资源较多、研发费用较高。

（2）产品量产初期需一定流动资金备货

一款新的产品需要经历产品定义、产品设计、产品验证、量产导入等阶段，在正式进入量产导入前要针对产品的功能、性能验证和应用开发，同时进行可靠性及其一致性验证。通常情况下，从设计研发至产品定形的过程中会经历多次流片及设计和工艺迭代，所需资金不菲；募投产品实现最终销售前期，公司需要大量流动资金购买晶圆并对芯片进行封装测试，以完成量产阶段备货；并且由于行业惯例，公司通常会授予客户一定的信用期与信用额度。这使得在新产品实现最终销售款项回流前公司现金流会较为紧张，需额外的流动资金进行补足。

与此同时，根据行业惯例，由于芯片的采购、生产周期较长，为满足客户滚动的生产需求及临时性的需求变动，提高客户满意度，避免缺货、断货的情况发生，公司需要在按客户订单交付的同时储备一定的库存水位。维持合理的库存规模也可以帮助公司更好的安排下游晶圆厂与封测厂生产活动，避免变更生产计划以提高运营效率。

此外，为保证项目的顺利进行，公司需准备一定的基本预备费与铺底流动资金。因此，本次募集资金投资项目除设备硬件费外的非资本性支出较大，需占用公司较大流动资金。

2、公司业务迅速增长，经营活动现金流量净额有所下降，经营所需资金需求较大

报告期内公司业务增长迅速，2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年

1-6 月，发行人分别实现营业收入 59,164.74 万元、56,019.00 万元、151,239.46 万元和 99,769.32 万元，2017 年至 2019 年复合年均增长率达 59.88%，且预计公司未来营业收入也将持续快速增长。

虽然公司随着业务规模不断扩张，治理结构也不断完善，并形成了有效的激励约束机制及内部管理制度。但随着本次募投项目的陆续实施，公司资产规模、经营规模将进一步扩大，相应的研发、销售及管理人员数量也将逐步上升，对公司在资源整合、技术开发、市场开拓等方面将提出更高的要求。同时，经营规模的快速增加也使得公司的备货规模相应增长，以满足现有客户的库存需求及未来客户的潜在需求，避免出现缺货、断货的情况发生。

此外，由于公司发展迅速，在业务扩张时，公司需按照与客户签订的商务条款给予客户一定的信用期。通常来说，公司会给予占公司业务比重较大的战略客户较长的信用期。这对公司的现金流管理水平提出了一定的挑战，也一定程度上造成了 2019 年度公司净利润上升但经营活动现金净流量一定程度下降的情况。

因此，本次向特定对象发行的部分募集资金补充公司流动资金，能有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司资源整合能力，吸引更多人才，是公司实现持续健康发展的切实保障，具有充分的必要性。

3、本次补充流动资金的测算依据及测算过程

(1) 公司未来三年收入测算

报告期内公司依托对关键技术和资源的持续投入，通过积极调整研发策略应对市场多样化、差异化的需求，继续扩大公司在目标市场的竞争优势，使得营业收入增长较为迅速，最近三年平均营业收入增长率为 59.88%。基于谨慎性原则，选择可比公司的营业收入加权平均复合增长率作为公司营业收入测算的基准。可比公司最近两年合并报表口径营业收入增长情况如下：

单位：万元

公司名称	2019 年度	2018 年度
汇顶科技	647,325.45	372,129.17
中颖电子	83,414.72	75,771.05
圣邦股份	79,249.49	57,239.27

公司名称	2019 年度	2018 年度
国科微	54,288.52	40,010.77
全志科技	146,336.03	136,468.97
加权平均复合增长率	48.27%	

资料来源：Wind

根据可比公司数据，假设公司未来三年营业收入增长率为 48.27%。以 2019 年度的营业收入 151,239.46 万元为基数，据此测算未来三年营业收入情况如下：

单位：万元

年份	2019 年	第一年	第二年	第三年
营业收入	151,239.46	224,237.72	332,469.82	492,941.96

注：上述测算不代表公司对未来三年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

(2) 补充流动资金具体测算过程

流动资金所需金额规模主要与公司经营性流动资产与经营性流动负债有关。一般来说，公司未来三年新增流动资金缺口计算公式如下：

新增流动资金缺口=第三年末流动资金占用金额-2019 年末流动资金占用金额。

其中，2019 年末的经营性流动资产和经营性流动负债各科目金额均按照资产负债表数据填列。未来三年末各项经营性流动资产和经营性流动负债金额由 2019 年末应收账款、预付款项、存货、其他应收款、应付账款、预收款项科目占营业收入的比例为基础进行测算。

单位：万元

项目	占营业收入比重	2019 年 (实际)	第一年 (测算)	第二年 (测算)	第三年 (测算)
营业收入(A)		151,239.46	224,237.72	332,469.82	492,941.96
应收账款	25.01%	37,830.01	56,089.30	83,161.74	123,301.15
预付款项	2.12%	3,213.58	4,764.67	7,064.42	10,474.17
存货	24.21%	36,610.86	54,281.71	80,481.68	119,327.52
其他应收款	0.13%	198.20	293.86	435.70	646.00
经营性流动资产小计(B)	51.48%	77,852.65	115,429.54	171,143.54	253,748.84
应付账款	8.61%	13,019.03	19,302.88	28,619.74	42,433.54
预收款项	0.18%	265.56	393.74	583.78	865.55

项目	占营业收入比重	2019 年 (实际)	第一年 (测算)	第二年 (测算)	第三年 (测算)
经营性流动负债小计 (C)	8.78%	13,284.59	19,696.62	29,203.52	43,299.10
流动资金需求量 D=B-C	42.69%	64,568.06	95,732.92	141,940.02	210,449.75
流动资金缺口合计					145,881.69

注：假设未来三年各项经营性资产、经营性负债占当年度营业收入的比例按 2019 年年末销售百分比计算。

- 1、流动资金需求量=经营性流动资产-经营性流动负债；
- 2、流动资金缺口合计=第三年流动资金需求量-2019 年流动资金需求量；
- 3、上述测算不代表公司对未来三年盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

根据测算，公司未来三年将面临着较大的资金缺口，营运资金缺口总额约为 145,881.69 万元。本次向特定对象发行股票拟补充流动资金总额不超过 75,000.00 万元，有利于缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展，具有合理性。

4、本次募投资金拟用于补流比例符合相关规定

发行人本次募投拟用于补充流动资金的总金额为 75,000 万元，占本次募投总金额 300,553.77 万元的比例为 24.95%，满足《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》中“用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的 30%”的规定。

二、募集说明书补充披露

发行人已在募集说明书“一、发行人基本情况”之“（五）财务性投资及类金融业务的具体情况”补充披露本次发行相关董事会决议日前六个月至今实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况。

三、中介机构核查意见

保荐机构及会计师的核查过程如下：

- 1、取得公司的财务报告、审计报告，查阅内部决策文件及信息披露文件，公司相关说明文件；
- 2、结合主管部门关于财务性投资及类金融业务的相关规定，对公司董事会决议日前六个月至今实施的对外投资、理财产品购买情况进行了核查；

- 3、查阅了本次募投项目的可行性研究报告；
- 4、复核了各募投项目的具体投资数额、资本性支出情况以及效益测算情况；
- 5、查阅了可比上市公司及可比募投项目的相关公开信息。

经核查，保荐机构及会计师认为：

1、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复报告出具日，申请人不存在实施或拟实施财务性投资（包括类金融投资）的情形；

2、截至最近一期末，申请人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

3、发行人本次募集资金拟用于补充流动资金的原因合理，符合发行人的商业模式与现实需要，补充流动资金项目规模合理，投入比例不超过募集资金总额的 30%，符合有关规定。

问题四

发行人 2019 年实现净利润 49,717 万元，同比增长 206.27%，经营活动产生的现金流量净额 5,561.98 万元，同比下降 58.58%。

请发行人披露经营活动现金流量净额与净利润在金额和变动趋势等方面不匹配的原因及合理性，是否与同行业可比公司一致。

请保荐人和会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、对问题的回复

（一）披露经营活动现金流量净额与净利润在金额和变动趋势等方面不匹配的原因及合理性

发行人 2018 年度、2019 年度实现净利润金额分别为 16,233.29 万元、49,717.00 万元，同比上升 206.27%；产生经营活动现金流量净额分别为 13,428.27 万元、5,561.98 万元，同比下降 58.58%。其中：2018 年度、2019 年度经营活动现金流入金额分别为 63,770.25 万元、131,914.85 万元，同比上升 106.86%；经营活动现金流出金额分别为 50,341.98 万元、126,352.87 万元，同比上升 150.99%。经营活动现金流入增幅小于经营活动现金流出增幅，由此导致经营活动现金流量净额与净利润呈反方向变动。

发行人经营活动现金流入主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金，经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金。发行人 2018 年度、2019 年度净利润及部分经营现金流量数据如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动比
归母净利润	49,717.00	16,233.29	206.27%
经营活动现金流量净额	5,561.98	13,428.27	-58.58%
销售商品、提供劳务收到的现金	121,848.64	57,621.10	111.47%
购买商品、接受劳务支付的现金	103,622.88	36,596.58	183.15%

销售商品、提供劳务收到的现金 2018 年度、2019 年度分别为 57,621.10 万

元、121,848.64 万元，同比上升 111.47%，销售商品、提供劳务收到的现金增幅小于实现净利润的增幅，一方面，相较于 2018 年，发行人于 2019 年度向账期较长的大客户销售占比大幅度增加，回款周期较 2018 年度增长；同时经销商所负责的终端客户普遍需求增长，基于长期以来的合作信任基础，发行人对部分经销客户的信用额度有所提高。

另一方面，购买商品、接受劳务支付的现金 2018 年度、2019 年度分别为 36,596.58 万元、103,622.88 万元，同比上升 183.15%，2019 年度涨幅较大主要系发行人因客户供货需求量大幅度上升，发行人备货量大幅度增加。**2019 年度发行人的客户结构进一步向知名手机厂商客户聚拢，基于此类客户在 2019 年度增长迅速，且备货需求非常大，导致发行人支出现金同比上升较高。**

发行人 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日存货结存金额如下表所示：

单位：万元

项目	账面余额		变动比
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	
在途物资	1,816.24	569.55	218.89%
原材料	12,531.54	6,761.96	85.32%
委托加工物资	8,453.19	1,512.11	459.03%
库存商品	16,222.77	6,059.65	167.72%
发出商品	273.18	150.57	81.43%
合计	39,296.92	15,053.85	161.04%

发行人 2019 年 12 月 31 日库存商品账面余额为 16,222.77 万元较 2018 年 12 月 31 日库存商品账面余额 6,059.65 万元上升 167.72%，主要系客户供货需求大幅度上升导致发行人备货大幅度增加；委托加工物资 2019 年 12 月 31 日期末账面余额 8,453.19 万元较 2018 年 12 月 31 日库存商品账面余额 1,512.11 万元上升 459.03%，主要系发行人 2020 年度在手订单及销售预测量大幅度上升导致委外加工厂 2019 年末产量大幅度增加。发行人采购量及备货量的大幅度增长导致“购买商品、接受劳务支付的现金”金额大幅度增加。

综上，发行人 2019 年度“销售商品、提供劳务收到的现金”的增幅小于“购买商品、接受劳务支付的现金”，导致发行人 2019 年度经营活动现金流量净额较 2018 年度有所下降。发行人 2019 年度经营活动现金流量净额与净利润呈反向

变动真实地反映了发行人销售规模快速增长、回款周期增加、备货量上升的实际情况，具有合理性。

（二）是否与同行业可比公司一致

同行业可比公司经营活动现金流量净额与净利润金额及变动情况如下：

单位：万元

可比公司	项目	2019 年度	2018 年度	变动比
国科微	归母净利润	6,812.78	5,617.10	21.29%
	经营活动现金流量净额	22,763.84	-7,561.72	100.00%
中颖电子	归母净利润	18,932.98	16,829.08	12.50%
	经营活动现金流量净额	21,955.97	10,358.66	111.96%
汇顶科技	归母净利润	231,735.67	74,249.86	212.10%
	经营活动现金流量净额	288,002.96	123,209.81	133.75%
圣邦股份	归母净利润	17,603.25	10,369.41	69.76%
	经营活动现金流量净额	14,451.55	8,367.47	72.71%
全志科技	归母净利润	13,463.04	11,812.74	13.97%
	经营活动现金流量净额	36,493.07	-6,979.85	100.00%
发行人	归母净利润	49,717.00	16,233.29	206.27%
	经营活动现金流量净额	5,561.98	13,428.27	-58.58%

同行业可比公司经营活动现金流量净额与净利润 2019 年度较 2018 年度均呈上升趋势。由于发行人 2019 年度整体回款周期变长、**客户需求大幅增长**、存货备货量大幅上升导致经营活动现金流量净额与净利润呈反向变动，因此发行人经营活动现金流量净额与净利润的变动趋势与同行业可比公司存在一定的差异，但有其原因及合理性。

二、募集说明书补充披露

发行人已在募集说明书“一、发行人基本情况”之“（六）经营活动现金流量净额与净利润情况”补充披露经营活动现金流量净额与净利润在金额和变动趋势等方面不匹配的原因及合理性，是否与同行业可比公司一致。

三、中介机构核查意见

保荐人和会计师核查了发行人损益表及现金流量表主要科目的变动原因，同

时取得了同行业可比上市公司的相关财务数据、指标，并对差异进行了分析。

经核查，保荐人和会计师认为，发行人经营活动现金流量净额与净利润呈反向变动存在合理性。

问题五

报告期内，发行人境外收入占比较高，且金额呈增长态势，2017 年度、2018 年度、2019 年度营业收入中境外收入占比分别为 68.42%、75.50%、71.70%。

请发行人补充说明新冠疫情、国际贸易摩擦等因素对其经营稳定性、募投项目实施及未来产能消化的不利影响，拟采取的应对措施，并充分披露相应风险。

请保荐人核查并发表明确意见。

回复：

一、对问题的回复

（一）新冠疫情对公司经营稳定性、募投项目实施及未来产能消化的影响，拟采取的应对措施

1、新冠疫情对公司经营稳定性、募投项目实施及未来产能消化的影响

受新冠疫情影响，全球经济压力加大，据世界银行于 2020 年 6 月发布《全球经济展望》报告，2020 年世界经济将下滑 5.2%，其余主要经济体均为负增长。但随着全国上下统筹推进疫情防控和复产复工，我国经济正逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势。国家统计局公布的数据显示，我国二季度 GDP 增长由负转正，增长 3.2%，新冠疫情带来的负面影响正逐步消除，经济发展韧性和活力得到进一步彰显。

此外，虽然新冠疫情对我国整体消费市场影响较大，使得我国手机总体销售量呈下滑态势，但受国内 5G 基站覆盖范围的逐步完善、5G 手机技术的逐步成熟等因素驱动，消费者对于 5G 手机接受度也在逐渐提高。根据中国信通院的数据，我国 5G 手机出货量占总体手机出货量的比例已由 2019 年 7 月的 0.2% 大幅提高至 2020 年 5 月的 46.3%。公司也积极部署 5G 产品的研发生产，抓住 5G 手机更新换代的需求，全力保证公司业绩的快速增长。

因此，新冠肺炎疫情虽然会对公司业务造成一定短期影响，但公司密切关注疫情的发展变化，积极采取措施应对，在困难中寻找和创造机遇，保证公司经营

营稳定性不受影响。2020 年上半年公司营业收入同比增长 93.64%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 130.99%，公司业绩仍维持稳定增长。

公司本次募投项目的实施方式为与晶圆厂合作建立前道晶圆生产专线模式。一方面，由于半导体晶圆制造对厂房环境的要求较高，通常采用高等级无尘洁净室以达到洁净度要求，并且也会采用极为严格的防护标准与过滤级别以确保空气中的微粒含量不会影响设备精度。另一方面，晶圆厂通常为封闭管理，人员流动控制严格，可以有效的防止晶圆厂中出现新冠疫情。截至本回复报告出具日，公司的合作晶圆厂均未出现受到新冠疫情影响而延迟交货等情况。因此，新冠疫情对本次募投项目的实施不会产生重大影响。

本次募投项目的产品主要应用于智能手机以及 5G 基站领域。据 2020 年 6 月 IDC 公布的数据，由于新冠肺炎对宏观经济的影响将继续影响消费者支出，预计 2020 年上半年智能手机出货量将下降 18.2%，2020 年全年全球智能手机市场出货量预计将下降 11.9%，至 12 亿部。但 IDC 也预测 5G 技术将成为智能手机市场复苏的催化剂，在 2021 年全球智能手机市场复苏中发挥重要作用，预计全球智能手机出货量将在 2021 年第一季度恢复增长，且在 2021 年度至 2024 年度维持正增长。

此外，受到疫情的影响，2020 年一季度我国 5G 基站的建设也相对放缓，但通信业正式复工后，因疫情延期的 5G 项目将加快落地。据工信部的消息，2020 年底中国移动建成 30 万个 5G 基站的目标不变，中国联通和中国电信将力争前三季度完成全年 25 万基站建设目标。在国内新冠疫情得到较好控制的背景下，我国 5G 的建设有望进一步提速。

综上所述，预计新冠疫情不会对公司募投项目的实施及未来产能消化产生较大不利影响。

2、拟采取的应对措施

为应对新冠疫情对公司生产、销售造成的潜在影响，发行人已经采取一系列有效应对，制定了有效的安全防护措施，大力推进复工复产。公司在第一时间为员工购买了充足的个人防护用品，并密切跟踪员工所在地新冠疫情严重程度，组织员工每日上报体温，确保公司员工的健康安全。

在确保公司员工安全与做好新冠肺炎防控措施的前提下，公司也根据当地政府的指导与统筹安排，并结合自身的经营规划，采取多项措施持续推进复工复产。保持持续的研发投入，加深与客户的合作沟通，加强管理水平的提升和成本的管控，尽最大可能降低疫情对公司生产经营的影响。随着全球疫情得到进一步有效控制，市场需求和消费者意愿有所恢复，疫情对公司生产经营方面的负面影响将有所减弱。

截至本回复报告出具日，公司已全面复工，生产经营已恢复正常。

（二）国际贸易摩擦对公司经营稳定性、募投项目实施及未来产能消化的不利影响，拟采取的应对措施

1、国际贸易摩擦对公司经营稳定性、募投项目实施及未来产能消化的影响

2018 年度、2019 年度与 2020 年 1-6 月公司营业收入中境内收入占比分别为 24.50%、28.30%和 41.39%，境内地区收入占比不断提高，**主要系公司终端客户境内交货需求增长所致**，且公司境外地区业务主要覆盖越南、韩国、香港等受国际贸易摩擦影响较小的国家或地区。

报告期内，公司的主要供应商位于日本、中国大陆与中国台湾，公司与主要供应商均建立了紧密的合作关系。报告期内公司供应商均按时正常交付，未有断供等情况发生。

当前，受国际贸易摩擦影响，半导体产业链国产替代化进程加速，国产半导体器件在国产品牌中的占比进一步提升，国内集成电路行业在需求的驱动下持续扩张。公司坚持自主研发，充分发挥公司技术储备、供应链管理、规模成本效应等综合优势，通过不断开发并推出类型丰富的高端产品占领市场先机，新推出的产品得到了客户的高度认可，公司在一线客户的占比不断提升。国产替代红利促进公司业绩快速增长，保证了公司持续保持充分的竞争力和广阔的增长空间。公司本次募投项目预计将打破境外企业在高端射频滤波器芯片与 5G 基站射频器件领域的垄断地位，拓展公司产品的应用领域，促进国产半导体产业链的发展。此外，根据 IDC 的预测，受新冠疫情影响，全球智能手机市场 2020 年总出货量约为 12 亿部，同比 2019 年将下降 11.9%，但有望于 2021 年后开始回升。根据 QYR Electronics Research Center 的预测，受到 5G 网络商业化建设的影响，自 2020

年起，全球射频前端市场将迎来快速增长。2018年至2023年全球射频前端市场规模预计将以年复合增长率16.00%持续高速增长，2023年接近313.10亿美元。

上述国际贸易摩擦对公司下游终端客户市场占有率分布产生了一定影响，但对公司未来持续盈利的影响相对有限，主要是因为：（1）全球射频前端市场处于高速增长状态，公司产品的市场前景广阔，根据QYR Electronics Research Center统计，预计全球射频前端市场规模将达到313.10亿美元，自2018年起实现16.00%的年均复合增长率；（2）根据IDC的数据，2020年第二季度全球智能手机出货量排名前五的公司分别为华为、三星、苹果、小米、OPPO。目前，公司终端客户群已覆盖了除苹果外的前五大主流手机厂商，国际贸易摩擦短期内可能会使公司的客户结构出现一定的调整，但长期来看，整体市场需求依然存在，因此，公司的总体经营稳定性不会受到国际贸易摩擦的较大影响；（3）公司向不同客户销售的同类产品具有通用性，虽然上半年备货相对较多，但不存在存货大幅减值损失的风险；（4）公司持续研发创新推出具有竞争力的新产品，并已于2019年度新推出不同种类的射频模组产品，此类新产品为公司未来的持续发展奠定了较好的基础；（5）通过本次募投项目的建设，公司将实现产品线的拓展，并通过新产品的市场导入，把握新的盈利增长点。在上述因素的影响下，国际贸易摩擦预计不会对公司经营稳定性产生较大不利影响。

国际贸易摩擦对公司5G基站领域客户的影响主要体现在其海外市场扩展上。但根据知名基站设备提供商的预测，截至2020年底，中国5G基站的预计建设数量将占全球建设数量的一半以上，因此，即使不考虑境外市场，境内5G基站射频器件的市场规模也已足够支撑公司本次募投项目的产能消化。

综上所述，国际贸易摩擦对公司经营稳定性、募投项目实施及未来产能消化不会造成重大不利影响。

2、拟采取的应对措施

为应对国际贸易摩擦对公司产生的潜在影响，发行人已经采取一系列有效应对措施，具体包括：

- （1）拓展公司客户广度与深度，积极评估贸易摩擦影响

为应对国际贸易摩擦，公司将积极开拓不同的客户群体并加深与现有客户的合作，目前公司产品已覆盖众多境内外领先的智能手机终端品牌，并与 5G 通信基站客户群体有部分重叠。未来公司将进一步深度挖掘现有手机品牌客户潜在需求，并积极开发新的通信基站领域优质客户，使不同领域客户、同一领域不同地域客户相互补充，降低国际贸易摩擦带来的影响。

此外，为保证客户供应链的稳定性，更好的服务终端客户，公司将持续关注国际贸易摩擦的最新进展，并与客户保持紧密的联系，评估贸易摩擦带来的潜在影响。公司也将就最新情况积极与客户沟通，提出积极有效的解决办法以继续保持现有的稳定合作关系。公司将密切关注国际政治形势的发展变化，积极采取措施应对，在困难中寻找和创造机遇。

（2）加快本次募投实施进度，完善供应商体系

公司在经营过程中重视与全球顶级的晶圆制造商、芯片封测厂商的紧密合作。公司已与知名晶圆制造商和芯片封测厂商形成了稳定的合作机制，建立了稳固、良好的合作关系，在产能供应链管理方面积累了丰富的经验。同时，由于公司销量逐年快速增长，已成为各上游外协厂商重要客户，良好的供应商管理有效地稳定了公司的大规模交付供给。另一方面，公司通过与上述知名厂商规划并制订长期产能规划、建设专线、协商保障产能供应等机制确保产能需求，降低了行业产能波动对公司产品产量、供货周期的影响。公司具备快速交付产品的能力，保障客户量产的顺利进行。

同时，公司将加快本次募投的实施进度，以期尽快完成与晶圆厂的合作，进一步加深公司与晶圆厂之间的合作与相互了解，确保公司提前锁定晶圆厂的产能，保障关键资源的供应速度。另一方面，公司募投项目的尽快实施也有助于我国半导体行业加快实现高端产品的国产替代化，打破国外技术封锁，使国产手机品牌与基站厂商维持正常的产品生产。最后，公司本次募投项目的实施也将完善公司的供应商体系建设，在与全球顶级晶圆厂保持紧密合作的同时，积极考察国内优秀晶圆厂，通过共建产线的方式促使国内晶圆厂的工艺升级，助力国内半导体产业链的发展与完善。

（3）扩展产品下游应用种类，对冲贸易摩擦影响

目前公司的产品主要应用于以手机为代表的消费类电子产品，产品类型较为集中。但公司始终坚持技术创新，不断推出新产品以丰富现有产品布局。2019年公司适时推出适用于5G制式sub-6GHz频段射频开关和低噪声放大器新产品，同时射频模组的开发和推广取得突破。上述新产品既丰富了产品布局，又进一步增强了公司的核心技术竞争力，有效的打破了国外企业在高端射频领域的垄断地位，可以较好地对冲贸易摩擦对公司原有产品带来的冲击。

此外，本次募投项目实施也有利于公司拓宽除消费类电子产品外的应用领域，如5G通信基站射频器件研发及产业化项目的实施将使公司的产品应用于通信基站领域应用，此外公司也在利用现有生产技术和人员储备积极拓展汽车电子等新的应用领域，并不断拓宽现有产品应用范围，以减少国际贸易摩擦对特定行业带来的风险。

二、募集说明书补充披露

发行人已在募集说明书“五、与本次发行相关的风险因素”之“（一）对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素”中补充披露相应风险。

三、中介机构核查意见

保荐机构的核查过程如下：

1、通过对申请人管理层以及相关负责人了解申请人复工复产情况以及新冠疫情与国际贸易摩擦对申请人销售、采购、生产等各方面造成的影响；

2、获取申请人2020年1-6月财务报表，了解申请人经营业绩受新冠疫情与国际贸易摩擦的影响情况；

3、取得了申请人2020年1-6月采购、销售明细，了解申请人采购的主要原材料、销售的主要产品情况以及客户、供应商情况；

4、获取了公司为应对新冠疫情制定的制度及有关证明，关注国家卫生健康委员会官方网站及相关媒体关于疫情的进展情况；

5、查阅了本次募投项目可研报告，了解申请人本次募投项目的具体情况。

经核查，保荐机构认为：

1、截至目前，申请人及其境内外子公司已实现全面复工复产，申请人已开始进行正常、连续的生产及经营；新冠肺炎疫情期间，申请人原材料采购、产品销售等日常订单或重大合同的履行不存在实质性障碍；

2、新冠疫情与国际贸易摩擦对申请人 2020 年半年度的经营业绩造成一定负面影响，但仅为暂时性影响，申请人已经采取必要的解决措施，未来期间能够恢复正常状态，预计对全年经营业绩情况的实施无重大负面影响；

3、目前新冠疫情与国际贸易摩擦对申请人终端客户不构成重大不利影响，不会对申请人持续经营能力构成重大不利影响；

4、本次新冠疫情及国际贸易摩擦对申请人未来生产经营预计不会产生重大不利影响。海外疫情持续蔓延或国际贸易摩擦进一步加剧可能对申请人未来生产经营造成一定的不利影响，申请人将充分披露风险。

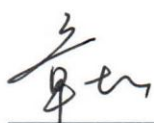
（此页无正文，为《关于江苏卓胜微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》之盖章页）



2020 年 9 月 26 日

（此页无正文，为《关于江苏卓胜微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》之签署页）

保荐代表人签名：


章志皓


李天怡

2020 年 9 月 26 日

中国国际金融股份有限公司公章：



2020 年 9 月 26 日

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读《关于江苏卓胜微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》的全部内容，了解本回复报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长、法定代表人签名：


沈如军


中国国际金融股份有限公司
2020年9月26日

保荐机构首席执行官声明

本人已认真阅读《关于江苏卓胜微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》的全部内容，了解本回复报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

首席执行官签名：



黄朝晖



中国国际金融股份有限公司

2020年9月26日